

2024年8月28日

関係各位

四国工業研究会セミナー エレクトロニクス in 香川

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、我が国最大級の公的研究機関として日本の産業や社会に役立つ技術の創出とその実用化や、革新的な技術シーズを事業化に繋げるための「橋渡し」「社会実装」機能に注力しています。そのための体制として産総研のコア技術を束ね、その総合力を発揮する「7領域+G-QuAT」があり、全国12か所の研究拠点で約2400名の研究者がイノベーションを巡る環境の変化やそれらを踏まえて策定された国家戦略等に基づき、ナショナルイノベーションシステムの中核的、先駆的な立場で研究開発を行っています。

このセミナーでは、パワーエレクトロニクスに関する最先端の研究を紹介いただきます。本セミナーを通じて、今後の新たなイノベーションのきっかけになる事を期待しております。

日時：2024年10月28日（月）14：30～17：00

場所：産業技術総合研究所四国センター 講堂（オンラインのハイブリッド開催）

主催：四国工業研究会

共催：産業技術総合研究所四国センター

参加費：無料

申込方法：以下の申込フォームからお申し込みください。

10月22日(火)締切 **会場参加の場合のみ**。Web参加の場合、申込み期限はありません。

<https://zoom.us/meeting/register/tJMuduChrzoEtwZ4J8GgM0VYZ74RNzLQ6F9>



- ・お申し込み後にメールにて、接続先（Zoom）をご案内いたします。（14時15分より接続可能です）
- ・Zoomのフォームを使用しているため、会場参加を希望されている方にも、Zoomの参加URLが自動的に送信されますので、ご了承願います。

<プログラム>

14：30～14：35 開会挨拶 **大西 芳秋 四国センター所長**

14：35～15：35 **日向 秀樹 副研究部門長 材料・化学領域 マルチマテリアル研究部門**

講演タイトル 「次世代パワーデバイス用高熱伝導窒化ケイ素放熱基板」

講演概要

次世代パワーデバイスの半導体はシリコンではなく、SiCやGaNを活用することが想定されている。これらの半導体は小型で高出力を出す代わりに、大きな発熱を伴い、その放熱が重要となる。窒化ケイ素セラミックスは高強度・高靱性で絶縁性を有するため、放熱基板として期待されている。この研究開発の動向について紹介する。

15：35～15：55 ***休憩***

15：55～16：55 **高橋 健司 総括研究主幹 エレクトロニクス・製造領域 先端半導体研究センター**

講演タイトル 「先端半導体パッケージ技術の現状」

講演概要

半導体産業はその重要性が再認識されここ数年で大きく変貌してきている。本講演では後工程と呼ばれる半導体パッケージについてその基礎と、高性能かつ省電力を実現するための3D化、チップレットなど先端技術の研究開発状況を平易に解説する。

16：55～17：00 **閉会挨拶 榎田 洋二 四国センター所長代理**

17：00～18：00 **懇親会**（会費 500 円）＊ 適格請求書の発行はできません

※登録いただきましたメールアドレス等の情報は、個人情報保護法のもと適切に管理し、本研究会に関する確認・連絡及び産総研主催のイベント案内にのみ利用します。